

**Zeitschrift:** Schweizer Ingenieur und Architekt  
**Herausgeber:** Verlags-AG der akademischen technischen Vereine  
**Band:** 118 (2000)  
**Heft:** 3

## Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 17.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



CD

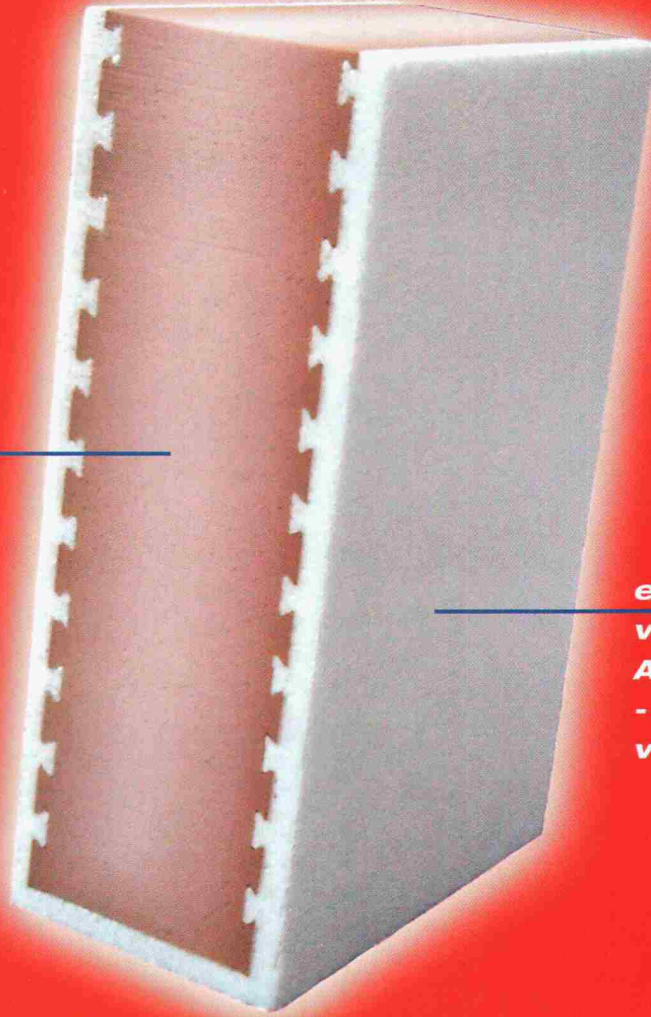


KO2



Microchip

# NEW GENERATION



**heavy**  
hochverdichteter  
Kern bringt  
dieselbe  
Wärmedämm-  
wirkung mit nur  
ca. der Hälfte  
der Plattenstärke

**easy**  
verputzbare  
Aussenschicht  
- problemlos  
verarbeitbar

## HiCompact<sup>®</sup>

*Die hochverdichtete Wärmedämmung  
der neuen Generation schafft das bisher  
Unmögliche und komprimiert das  
Dämmvermögen im Verhältnis 1 : 1,8.  
Planern und Architekten bringt  
HiCompact<sup>®</sup> Aussen und Innen mehr  
Freiraum. Den Bauherren mehr  
Nutzfläche bei geringeren Gesamtkosten.*



gonon  
Isolation AG (SA)  
CH-8226 Schleithelm  
Telefon 052/680 17 21

[www.hicompact.ch](http://www.hicompact.ch)